

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）为发挥在海外市场的整体优势，优化和调整债务结构，降低资金成本，公司的境外全资子公司 HongKong Dongshan Holding Limited（中文名：香港东山控股有限公司，以下简称“香港控股”）拟在境外委任渣打银行(香港)有限公司（以下简称“渣打银行”）作为“**牵头安排行和簿记行**”或“**牵头行**”为香港控股在境外向渣打银行等金融机构申请贷款融资，贷款总额不超过 2.5 亿美元。本次融资的条件包括但不限于：公司及全资子公司 Multi-Fineline Electronix Singapore Pte. Ltd(中文名：维讯柔性电路板新加坡私人有限公司，以下简称“新加坡维信”)为上述贷款提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：HongKong Dongshan Holding Limited
- 2、设立日期：2018 年 6 月 25 日
- 3、注册资本：100 美金
- 4、注册地点：中国香港
- 5、主要业务：新型电子元器件及其他 PCB 产品的研发、制造、销售。
- 6、股权关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
- 7、香港控股一年一期主要财务数据：

单位:人民币元

项目	2019年12月31日(经审计)	2020年3月31日(未经审计)
资产总额	327,536,754.51	332,649,280.73
负债总额	7,673.82	540,049.63
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,673.82	540,049.63
净资产	327,529,080.69	332,109,231.10
	2019年1-12月(经审计)	2020年1-3月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-3,274.55	-526,748.27
净利润	-3,274.55	-526,748.27

三、拟签署担保协议的内容

本公司及全资子公司新加坡维信为香港控股在境外向渣打银行等金融机构获取总额不超过2.5亿美元的贷款融资提供连带责任保证担保,最终实际担保总额将不超过公司股东大会审议通过的担保额度。同时,公司授权董事会办理本次贷款融资及保证担保相关事宜,包括与相关机构协商确定具体融资方式、融资规模、融资期限、担保期限、贷款条件等,并以最终签署的贷款协议、保证协议等相关融资文件为准。

四、独立董事意见

经核查,我们认为:公司为全资子公司 HongKong Dongshan Holding Limited 向境外金融机构融资提供担保,有利于发挥公司在海外市场的整体优势,优化和调整债务结构,降低资金成本,符合上市公司的利益,本次担保事项履行了必要的审议程序,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意上述事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年7月31日,公司及所属子公司对外担保总额(余额)为人民币533,052.11万元,占公司2019年度经审计净资产的61.65%,无逾期担保,且不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情形。

六、备查文件

《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2020年7月31日